



京セラ株式会社 2023年3月期 第3四半期 決算説明会
(2023年2月1日開催)

代表取締役社長 谷本 秀夫 スピーチ

<1. (中表紙) 1. 2023年3月期第3四半期 決算概要>

<2. 2023年3月期第3四半期累計 決算概要 (1) >

当第3四半期累計期間の売上高は、半導体関連市場向け部品の増産対応が寄与したことに加え、円安の効果もあり、前年同期に比べ12.6%増加の1兆5,265億円となり、第3四半期累計期間として過去最高を更新しました。

一方、利益については、増収及び円安の効果はあったものの減少しました。

原材料価格や物流コスト等の上昇、及びコミュニケーション事業での大幅な売上減少に加え、当第3四半期(2022年10月~12月)に入り、スマートフォン関連部品の需要が減速したことも影響しました。また、訴訟や年金債務に関する一時費用、合計約100億円の計上もあり、減益となりました。

<3. 2023年3月期第3四半期累計 決算概要 (2) >

設備投資額及び有形固定資産減価償却費は、高需要な部品の生産能力拡大のための設備導入や新棟建設等により、増加しました。研究開発費は、新規事業の創出に向けた開発を推進したことにより、増加しました。

<4. 2023年3月期第3四半期累計 事業セグメント別売上高>

事業セグメント別の売上高は、全てのセグメントで増加しました。

<5. 2023年3月期第3四半期累計 事業セグメント別利益>

事業セグメント別の利益については、「コアコンポーネント」は大幅に増加したものの、「電子部品」は横ばいにとどまり、「ソリューション」は減少しました。

続いて、各事業セグメントの状況を前年同期と比較してご説明します。

<6. 2023年3月期第3四半期累計 事業セグメント別業績 (1) コアコンポーネント>

まず、「コアコンポーネント」です。

半導体関連部品事業において、5Gなどの情報通信市場向けにセラミックパッケージ及び有機基板の需要が増加しました。また、産業・車載用部品事業において、半導体製造装置用ファインセラミック部品などの高付加価値製品の需要が増加したことにより、増収となりました。

利益は、増収に加え円安効果もあり、大幅に増加し、利益率は15.7%へ向上しました。

<7. 2023年3月期第3四半期累計 事業セグメント別業績 (2) 電子部品>

「電子部品」は、産業機器市場や自動車関連市場向けを中心にコンデンサなどの需要が増加したことに加え、円安効果もあり、増収となりました。

一方、利益は、増収及び円安効果はあったものの、原材料等の価格高騰の影響やスマートフォン向け部品の需要が減速したことに加え、子会社において年金債務に係る追加費用約30億円を計上したこともあり、ほぼ横ばいとなりました。

<8. 2023年3月期第3四半期累計 事業セグメント別業績 (3) ソリューション>

「ソリューション」は、機械工具事業及びドキュメントソリューション事業における主要製品の販売増に加え、円安効果もあり、増収となりました。

利益は、コミュニケーション事業において、携帯電話端末の販売台数の大幅な減少により損失を計上したことに加え、各事業で原材料価格や物流コスト等の高騰の影響を受けたことから減少しました。

以上が当第3四半期累計期間の決算概要です。続いて、通期業績予想についてご説明します。

<9. (中表紙) 2. 2023年3月期通期 業績予想>

<10. 2023年3月期 業績予想 (1) >

2023年3月期通期の業績予想については、当第3四半期累計期間の実績及び当第4四半期(2023年1月~3月)の見通しを踏まえ、修正しました。

世界的にインフレが加速し、景気が低迷する中、当社は半導体関連市場を中心に売上を伸ばしてきましたが、当第4四半期においては、スマートフォン向け部品の需要減及び原材料等のコストの更なる上昇が予想されます。

これらの見通しに鑑み、売上高は前回予想から変更ありませんが、利益については、営業利益を540億円、税引前利益を500億円、親会社の所有者に帰属する当期利益を300億円、それぞれ減額しています。

なお、為替レートについては変更ありません。

<11. 2023年3月期 業績予想 (2) >

設備投資額、有形固定資産減価償却費についてもそれぞれ見直しています。

研究開発費については変更ありません。

<12. 2023年3月期 事業セグメント別売上高予想>

事業セグメント別の売上高は、「コアコンポーネント」を150億円、「電子部品」を70億円下方修正した一方、「ソリューション」は230億円上方修正しています。

<13. 2023年3月期 事業セグメント別利益予想>

事業セグメント別の利益は、全てのセグメントで下方修正しています。

<14. 2023年3月期通期 事業セグメント別 業績予想修正の要因>

各セグメントの修正要因についてご説明します。

「コアコンポーネント」は、半導体関連部品事業におけるスマートフォン向けセラミックパッケージの需要減に加え、原材料やエネルギーコストの高騰により、売上、利益ともに前回予想には届かない見通しです。

「電子部品」は、スマートフォン向け各種電子部品の需要減やコスト増、及び当第3四半期に計上した年金債務に係る追加費用約30億円の影響により、売上、利益ともに減額しています。

「ソリューション」は、当第3四半期までの実績を踏まえ、売上は前回予想から上方修正するものの、利益についてはコミュニケーション事業の損失拡大及び各事業におけるコスト増の影響を主因に下方修正しました。

足元では景気減速の影響から厳しい事業環境にありますが、需要回復期に着実に収益獲得につながられるよう、引き続き高収益な部品を中心に増産体制の構築を図るとともに、低収益事業の改善に向けた取り組みを進めてまいります。

以上

将来事象に関する注意事項

当資料には、将来の事象についての2023年3月期第3四半期決算説明会開催日(2023年2月1日開催)時点における当社グループの期待、見積り及び予測に基づく記述が含まれています。これらの将来の事象についての記述には、既知及び未知のリスク、不確実な要因並びにその他の要因が内包されており、当社グループの将来における実際の財政状態及び活動状況が、当該将来の事象についての記述によって明示または黙示されているところと大きく異なる場合があります。詳細は、当社ホームページに掲載の「将来の見通しに関する記述等について」をご参照ください (<https://www.kyocera.co.jp/ir/disclaimer.html>)。